

02;06

# Методика определения параметров радиационных дефектов и прогноза радиационной стойкости МОП-транзисторов

© М.Н. Левин, Е.В. Бондаренко, А.Е. Бормонтов,  
А.В. Татаринцев, В.Р. Гитлин

Воронежский государственный университет  
E-mail: levin@phys.vsu.ru

Поступило в Редакцию 26 февраля 2010 г.

Представлен анализ радиационной стойкости МОП-транзисторов, учитывающий как эффекты образования радиационно-индукционного заряда в объеме окисла и на поверхностных состояниях, так и релаксационные процессы термической и туннельной разрядки накопленного заряда. Методика прогнозирования радиационной стойкости включает процедуру определения параметров радиационных дефектов из экспериментальной дозовой зависимости, полученной при большой мощности радиации, и температурно-временных зависимостей релаксации порогового напряжения. Установленные параметры позволяют предсказать поведение МОП-транзистора под воздействием излучения любой мощности, включая низкоинтенсивную радиацию.

Одним из направлений исследования воздействий ионизирующих излучений (ИИ) на структуру металл–окисел–полупроводник (МОП) является разработка методов прогноза радиационной стойкости МОП интегральных схем к воздействию низкоинтенсивного космического излучения.

Суть проблемы состоит в следующем. При воздействии ИИ на МОП-структуру происходит образование положительного радиационно-индукционного заряда в окисле и поверхностных состояниях (ПС) на границе полупроводник–окисел. Наряду с этим протекают долговременные процессы туннельной и термической разрядки накопленного заряда. Соотношение этих процессов определяет изменение зарядового состояния МОП-структуры в процессе воздействия ИИ. При действии ИИ большой мощности дозы при низкой температуре

определяющим является накопление заряда и туннельная разрядка не вносит существенного вклада. При малой мощности дозы, что имеет место при воздействии низкоинтенсивного космического излучения, процессы накопления заряда и его туннельной разрядки становятся соизмеримыми.

Сложность решения проблемы обусловлена тем, что проведение натурных испытаний не представляется возможным из-за больших времен испытаний, соизмеримых со временем эксплуатации прибора. В связи с этим актуальной задачей является разработка методики прогноза радиационной стойкости МОП-транзисторов (МОПТ) к воздействию низкоинтенсивного ИИ, основанной на исследовании отклика прибора к воздействию излучения с большой мощностью дозы.

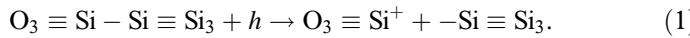
В настоящей работе рассмотрена модель МОП-структурь, учитываяющая наличие дефектов в окисле и на его границе с полупроводником, представлены результаты моделирования процессов накопления заряда при воздействии ИИ, а также методика прогноза радиационной стойкости МОПТ к воздействию ИИ малой мощности дозы. Методика основана на анализе экспериментальных дозовых и температурно-временных зависимостей порогового напряжения, измеренных при большой мощности дозы радиации, и решении системы уравнений, описывающих радиационно-термические процессы под воздействием ИИ с любой мощностью дозы, включая малые мощности.

Исследование воздействия ИИ на МОПТ с высококачественными слоями двукиси кремния, полученными „сухим“ окислением, показывают синхронное изменение зарядов в окисле и на ПС [1,2], что позволяет сделать вывод о едином механизме процессов радиационной генерации и отжига этих зарядов и выбрать для анализа воздействия ИИ следующую модель. В диэлектрике имеется два типа уровней радиационных дефектов: первый — глубокий энергетический уровень, соответствующий радиационно-индущированным  $E'$ -центрам, равномерно распределенным по толщине диэлектрика; второй — ПС ( $P_b$ -центры), расположенные вблизи границы Si—SiO<sub>2</sub> (в слое толщиной 10 nm), дающие спектр уровней, равномерно распределенный по ширине запрещенной зоны полупроводника.

В процессе воздействия ИИ в диэлектрике МОП-структуры происходит генерация электронно-дырочных пар, разделение этих пар внешним полем, уход электронов из окисного слоя в электроды и захват дырок на ловушечные центры в диэлектрике с образованием

несущего положительный заряд  $E'$ -центра [3,4]. Процесс захвата дырок продолжается до компенсации внешнего поля электрическим полем накапливаемого объемного заряда и прекращения разделения электронно-дырочных пар в электрическом поле.

На границе Si—SiO<sub>2</sub> происходят реакции с образованием  $E'$ -центров и  $P_b$ -центров, например, следующего типа:



Заряд  $P_b$ -центров определяется величиной поверхностного потенциала.

Процессы туннельной и термической разрядки накопленного в диэлектрике заряда могут быть описаны выражениями [5]

$$P_t(x, t) = P(0, t) \exp(-\alpha \exp(-\beta x)t), \quad (2)$$

$$P_t(E_t, t) = P(E_t, 0) \exp(-AT^2 \exp(-E_t/kT)t), \quad (3)$$

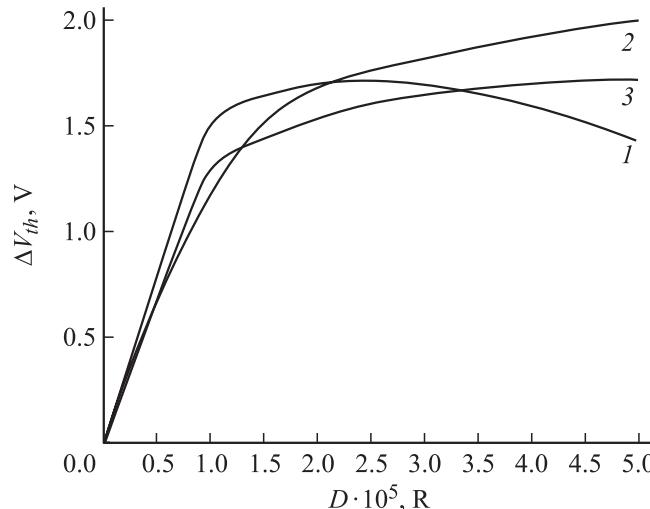
где  $\alpha$  и  $\beta$  — частотный и барьерный факторы соответственно ( $\alpha \equiv \hbar/16m^*\sigma_p$ ;  $\beta \equiv m^*\Delta E_t/2h$ ;  $\Delta E_t$  — высота барьера,  $m^*$  — эффективная масса электрона,  $h$  — постоянная Планка);  $E_t$  — энергия дырочного центра,  $A$  — феноменологический параметр, который зависит от природы дырочного центра.

Численное моделирование процессов накопления радиационного заряда в структуре poly-Si—SiO<sub>2</sub>—Si проводилось на основе системы уравнений, представленных в [6]. В расчетах принято, что энергия квантов рентгеновского излучения составляет 20 keV, экспозиционная доза до  $5 \cdot 10^5$  R, толщина слоя SiO<sub>2</sub>  $d = 100$  nm, концентрация легирующей примеси в полупроводнике  $N_B = 10^{15}$  cm<sup>-3</sup>, материал затвора — легированный фосфором поликремний, подвижность электронов  $\mu_n = 10^2$  cm<sup>2</sup> · V<sup>-1</sup> · s<sup>-1</sup>, подвижность дырок  $\mu_p = 0.6 \cdot 10^{-3}$  cm<sup>2</sup> · V<sup>-1</sup> · s<sup>-1</sup>. Полевые зависимости сечений захвата для дырок  $\sigma_p(E)$  и электронов  $\sigma_n(E)$  учтены выражениями [5]

$$\sigma_p(E) = 1.4 \cdot \sigma_p^s (1.0 + 1.9 \cdot 10^{-4} E^{\sigma_p^f})^{-1}, \quad (4)$$

$$\sigma_n(E) = \sigma_n^s (1.0 + 10^{-4} E^{\sigma_n^f})^{-1}, \quad (5)$$

где  $\sigma_{n,p}^{f,s}$  — варьируемые параметры, определяющие абсолютную величину и характер полевой зависимости сечений захвата.



**Рис. 1.** Дозовые зависимости сдвига порогового напряжения  $\Delta V_{th}$  при различных наборах параметров: 1 —  $\sigma_p^f = 0.8$ ,  $\sigma_n^f = 0.8$ ,  $\sigma_n^s = 10^{-14}$ ,  $N_{t1} = 4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_{t2} = 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ ; 2 —  $\sigma_p^f = 1.0$ ,  $\sigma_n^f = 1.2$ ,  $\sigma_n^s = 10^{-14}$ ,  $N_{t1} = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_{t2} = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ; 3 —  $\sigma_p^f = 0.8$ ,  $\sigma_n^f = 0.8$ ,  $\sigma_n^s = 5.0 \cdot 10^{-14}$ ,  $N_{t1} = 4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_{t2} = 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ ; остальные параметры и условия набора дозы для всех кривых одинаковы.

Модель позволила провести анализ влияния параметров радиационных дефектов на характер изменения величины порогового напряжения  $\Delta V_{th}$  и его составляющих  $\Delta V_{0r}$  и  $\Delta V_{it}$ , связанных с изменением радиационно-индуцированного заряда в окисле и на ПС соответственно. Анализировалось влияние сечений захвата для электронов и дырок  $\sigma_{n,p}^{f,s}$ , концентрации объемных и поверхностных ловушек  $N_{t1,t2}$ , их энергии активации. Установлено, что при изменении указанных параметров расчетные дозовые зависимости  $\Delta V_{th}(D)$  имеют подобный вид только на начальных участках. С увеличением дозы характер этих зависимостей существенно различается (рис. 1). Наиболее существенное влияние на вид дозовой зависимости оказывают характер полевой зависимости сечения захвата для дырок и концентрации дефектов. Следовательно, прогнозировать характер изменения порогового напряжения МОПТ по виду его дозовой зависимости на начальном участке или по значению изменения порогового напряжения при каком-либо фиксированном

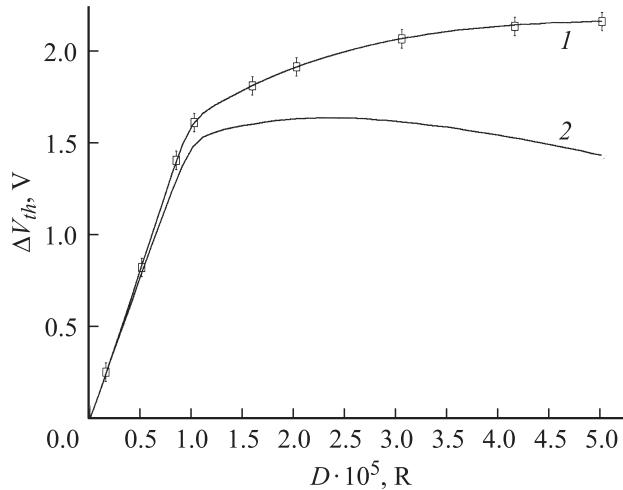
значении экспозиционной дозы не представляется возможным, если не известны параметры дефектов. Эти параметры могут быть определены варьированием их величин для наилучшего соответствия расчетной и экспериментальной дозовых зависимостей.

Энергии активации ловушек могут быть оценены из релаксационных зависимостей составляющей порогового напряжения  $\Delta V_{0t}$  при температурах, при которых происходит отжиг заряда, захваченного на соответствующие уровни ловушек (параметры  $E_t$  и  $A$  в выражении (3)). Частотный и барьерный факторы  $\alpha$  и  $\beta$ , определяющие туннельную разрядку  $\Delta V_{0t}$  (см. (2)), а также эффективные параметры, определяющие долговременную разрядку  $\Delta V_{it}$ , могут быть определены из релаксационных зависимостей при низкой температуре, когда термическая разрядка отсутствует.

Задача определения оставшихся параметров ловушек в окисном слое и на границе Si–SiO<sub>2</sub> сводится к подбору таких величин этих параметров, чтобы минимизировать отклонение расчетных дозовых зависимостей радиационного сдвига порогового напряжения  $\Delta V_{th}$  и его составляющих  $\Delta V_{0t}$  и  $\Delta V_{it}$  от соответствующих экспериментальных зависимостей, измеренных в реальном времени при большой мощности дозы радиации. Для решения этой задачи разработана процедура, которая включает следующие этапы: выбор диапазонов значений варьируемых параметров, потенциально содержащих локальные минимумы; нахождение значений варьируемых параметров, при которых эти минимумы достигаются в каждом из диапазонов; определение оптимального набора варьируемых параметров.

На основе предложенной модели, используя дозовую зависимость при большой мощности дозы ( $10^2 \text{ R} \cdot \text{s}^{-1}$ ) и кривые изотермической релаксации  $\Delta V_{0t}$  и  $\Delta V_{it}$  при температурах 300 и 750 K, были установлены следующие параметры радиационных дефектов:  $\sigma_p^f = 1.0$ ;  $\sigma_n^f = 0.8$ ;  $\sigma_p^s = 1.4 \cdot 10^{-12} \text{ cm}^{-2}$ ;  $\sigma_n^s = 10^{-14} \text{ cm}^{-2}$ ;  $E_{t1} = 0.65 \text{ eV}$ ;  $N_{t1} = 4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ;  $N_{t2} = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ . С использованием этих параметров, в качестве примера, рассчитана дозовая зависимость сдвига порогового напряжения  $\Delta V_{th}$  *n*-канального МОПТ (рис. 2, кривая 2) при малой мощности дозы ( $10^{-1} \text{ R} \cdot \text{s}^{-1}$ ).

Существенно меньшие значения радиационного сдвига  $\Delta V_{th}$  в случае малой мощности дозы радиации обусловлены тем, что становятся соизмеримы процессы образования радиационно-индукционного заряда в диэлектрике вблизи границы и его туннельной разрядки. Уменьшение



**Рис. 2.** Дозовые зависимости изменения порогового напряжения  $\Delta V_{th}$  *n*-канального МОПТ при различных мощностях доз:  $10^2 P \cdot s^{-1}$  (1) и  $10^{-1} R \cdot s^{-1}$  (2).

величины  $\Delta V_{th}$  с ростом дозы радиации происходит за счет роста отрицательного заряда на ПС.

Таким образом, может быть предложена следующая методика прогноза изменения порогового напряжения МОПТ при воздействии ИИ малой мощности дозы:

1) из экспериментальной зависимости временной релаксации порогового напряжения при повышенной температуре ( $T = 750$  K), при которой вкладом туннельной разрядки можно пренебречь, определить параметры термической разрядки;

2) из экспериментальной зависимости релаксации порогового напряжения при низкой температуре ( $T = 300$  K), когда изменение напряжения происходит преимущественно за счет туннелирования, определить параметры туннельной разрядки;

3) из наилучшего совпадения экспериментальной и расчетной дозовых зависимостей изменения порогового напряжения при большой мощности дозы определить недостающие параметры ловушек в окисле;

4) рассчитать дозовую зависимость изменения порогового напряжения для необходимой мощности радиационной дозы.

## Список литературы

- [1] Кадменский А.Г., Кадменский С.Г., Левин М.Н. и др. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. № 3. С. 41–45.
- [2] Levin M.N., Maslovsky V.M. // Solid State Comm. 1994. V. 90. P. 813–816.
- [3] Grove A.S., Snow E.H. // Proc. IEEE. 1966. V. 54. P. 894–895.
- [4] Stanley A.G. // IEEE Trans. Electron Dev. 1967. V. 14. P. 134–138.
- [5] McWhorter P.J., Miller S.L., Miller W.M. // IEEE Trans. Nucl. Phys. 1990. V. 37. N 6. P. 1682–1689.
- [6] Левин М.Н., Татаринцев А.В., Макаренко В.А., Гитлин В.Р. // Микроэлектроника. 2006. Т. 35. № 5. С. 382–391.

Письма в ЖТФ, 2010, том 36, вып. 15